



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04180566 A

(43) Date of publication of application: 26.06.92

(51) Int. Cl **C23C 16/44**
C23C 16/48
C23C 16/50
H01L 21/205
H01L 21/285
H01L 21/31

(21) Application number: 02309479
(22) Date of filing: 14.11.90

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
(72) Inventor: SHIBUYA MUNEHIRO
KITAGAWA MASATOSHI
KAMATA TAKESHI
HIRAO TAKASHI

(54) THIN FILM FORMING DEVICE

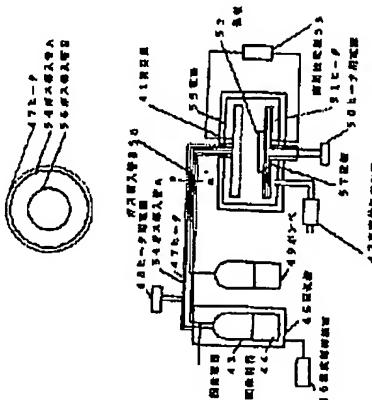
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of a powdery product in a gas introducing pipe by forming the introducing pipe for gaseous raw materials into multipipe structure and heating the pipe by an external heater at the time of forming thin films from the plural raw materials by a plasma CVD method.

CONSTITUTION: A solid container 43 housing a solid material 44 (for example, $TaCl_5$, etc.) is disposed into a thermostatic chamber 45 where the solid material 44 is evaporated. The vapor thereof is introduced together with the gas (for example, N_2O) in a cylinder 49 from an electrode 55 in common use as a gas introducing port into a vacuum chamber 41 subjected to vacuum evacuation, where the gases are cracked by plasma and the thin films (Ta_2O_5 , etc.) are formed on the substrate 52. The evaporated solid material 44 is introduced into the vacuum chamber 41 via the gas introducing pipe A54 held at the temp. higher than the evaporation temp. by a heater 47. On the other hand, the gas in a cylinder 9 is introduced into the vacuum chamber 41 via the gas introducing pipe B56 disposed on the inner side of the gas introducing pipe A54. The generation of the powdery product by mixing of the gases with each other is

prevented in this way and the films having the high uniformity are deposited.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



⑫ 公開特許公報 (A) 平4-180566

⑬ Int. Cl. 5	識別記号	厅内整理番号	⑭ 公開 平成4年(1992)6月26日
C 23 C 16/44		8722-4K	
16/48		8722-4K	
16/50		8722-4K	
H 01 L 21/205		7739-4M	
21/285	C	7738-4M	
21/31	C	8518-4M	

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

⑬ 発明の名称 薄膜形成装置

⑭ 特 願 平2-309479
 ⑮ 出 願 平2(1990)11月14日

⑯ 発明者 滝 谷 宗 裕 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑯ 発明者 北 川 雅 俊 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑯ 発明者 錄 田 健 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑯ 発明者 平 尾 孝 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑯ 出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
 ⑯ 代理人 弁理士 松田 正道

明細書

1. 発明の名称

薄膜形成装置

2. 特許請求の範囲

(1) 真空装置内に2種類以上の原料を導入し、外部よりエネルギーを印加して原料を分解することにより薄膜を形成する薄膜形成装置において、前記2種類以上の原料を導入するための導入管が多管構造となっており、その導入管は、外部ヒータによって加熱できることを特徴とする薄膜形成装置。

(2) 外部より前記真空装置内に電界を印加し、前記原料をプラズマ分解することを特徴とする請求項1記載の薄膜形成装置。

(3) 外部より前記真空装置内に熱を加え、前記原料を分解することを特徴とする請求項1記載の薄膜形成装置。

(4) 外部より前記真空装置内に光を照射し、前記原料を分解することを特徴とする請求項1記載の薄膜形成装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、真空装置内に原料ガスを導入し、減圧状態に保ち、外部から例えれば電界、熱、光等のエネルギーを印加し、原料ガスを分解することによって薄膜を形成する薄膜形成装置に関する。

従来の技術

従来、原料ガスをプラズマ分解するいわゆるプラズマCVD法は、第3図に示すような装置構成で行なわれている。すなわち、第3図において、21は真空に排気可能な真空室、22はそのための真空排気ポンプである。35は電極を兼ねたガス導入口、32はガラス、ステンレス、シリコンウエハー等の基板である。また、31は、基板32を加熱するためのヒータ、30はそのヒータ用電源、36は基板32側の電極である。また、33は、電極35、36に高周波電界を印加するための高周波電源である。

他方、固体容器23内のTaC_{1-x}、TaF₆等の固体材料24は恒温槽25内に配され、固体材料2

4が気化または気化しやすい温度に保たれる。26はそのための温度制御装置である。気化した固体材料24はヒータ27によって恒温槽25より高い温度に加熱されたガス導入管34を通して真空室21内に導入される。28はそのヒータ用電源である。また、29は、ガスを内蔵したポンベである。34は、気化した固体材料や、ポンベ29からのガスを真空室21に導入するための導入管である。

次に、本薄膜形成装置の動作を説明する。

真空排気ポンプ22によって真空室21を排気した後、ガス導入口を兼用する電極35より、例えば原料ガスとしてTaCl₅とポンベ29内のガス、例えばN₂Oを0.1-10Torr程度の圧力まで導入する。この間、基板32はヒータ31によって100-500°C程度の温度に加熱される。この後、電源33により電極35、36の間に電界を加え、プラズマを発生させ、原料ガスを分解すると基板32上にTa₂O₅薄膜が堆積させられる。

発明が解決しようとする課題

管の中で混合されてしまうためガスの一部分が反応を起こし、ガス導入管内に粉末状の生成物を発生した。これに対して、本発明では、ガス導入管が2重構造になっているので、反応は起こらず、ガス導入管内に粉末状の生成物は発生しない。

実施例

以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1図は本実施で使用する薄膜形成装置の概略図である。図において、41は真空に排気可能な真空室、42はそのための真空排気ポンプである。55は電極を兼ねたガス導入口、52はガラス、ステンレス、シリコンウエハー等の基板である。また、51は、基板52を加熱するためのヒータ、50はそのヒータ用電源、57は基板52側の電極である。また、53は、電極56、57に高周波電界を印加するための高周波電源である。

他方、固体容器43内のTaCl₅、TaF₅等の固体材料44は恒温槽45内に配され、固体材料44が気化または気化しやすい温度に保たれる。4

しかしながらTa₂O₅、TiO₂、WO₃、Y₂O₃、HfO₂等の薄膜を形成する場合、原料は、例えばTaCl₅、TaF₅、Ta(OC₂H₅)₅の様に固体または液体の場合が多い。この固体材料はヒータ27等によって加熱され気化することによって真空室21内に導入される。しかしながらこれらの固体材料は気化した状態で、他の原料のO₂やN₂O等のガスと混合されると固体材料の一部分が反応してしまい、ガス導入管34内に粉末状の生成物を発生するという課題がある。

本発明は上記従来の薄膜形成装置の課題に鑑み、固体材料を安定に供給できる薄膜形成装置を提供するものである。

課題を解決するための手段

本発明は、固体容器またはガスポンベと真空室をつなぐガス導入管を2重構造にして種類の異なるガスが真空室に到達するまで混合しないようにしたものである。

作用

従来の方法では2種類の異なるガスがガス導入

管の中で混合されてしまうためガスの一部分が反応を起こし、ガス導入管内に粉末状の生成物を発生した。これに対して、本発明では、ガス導入管が2重構造になっているので、反応は起こらず、ガス導入管内に粉末状の生成物は発生しない。

実施例

以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第2図は本実施で使用する薄膜形成装置の概略図である。図において、41は真空に排気可能な真空室、42はそのための真空排気ポンプである。48はヒータ用電源である。また、49は、ガスを内蔵したポンベである。56は、ポンベ49からのガスを真空室41に導入するためのガス導入管Bである。

すなわち、第2図に示すように、ポンベ49内のガスを真空室41へ導入するガス導入管B56は、気化した固体材料44を真空室41へ導入するガス導入管A54内に2重状態で組み込まれている。

次に、本薄膜形成装置の動作を説明する。

真空排気ポンプ42によって真空室41を排気した後、ガス導入口を兼用する電極55より、例えば原料ガスとしてTaCl₅とポンベ49内のガス、例えばN₂Oを0.1-10Torr程度の圧力まで導入する。すなわち、気化された固体材料44はヒータ47によって気化温度よりも高い温度に保持されたガス導入管A54を通して真空室41内に

導入される。他方、ポンベ49内のガスはガス導入管A54の内側に屈されたガス導入管B56を通して真空室41内に導入される。従って、導入管の中で反応は起こらない。

この間、基板52はヒータ51によって100-500°C程度の温度に加熱される。この後、電源53により電極55、57の間に電界を加え、プラズマを発生させ、原料ガスを分解すると基板52上にTa₂O₅薄膜が堆積させられる。

第3図は、第1図で示した本発明の薄膜形成装置および第4図で示した従来の薄膜形成装置を用いて、Ta₂O₅薄膜を堆積した場合のリーク電流特性を示している。固体材料44としてTaCl₅、ポンベ49内のガスはN₂Oを用いた。

従来の装置を用いて堆積したTa₂O₅薄膜に比べ、本発明の装置を用いて堆積したTa₂O₅薄膜の方がリーク電流密度が小さくなっていることがわかる。

発明の効果

以上述べたように、従来の薄膜形成装置では固体材料とN₂OやO₂等の反応ガスの一部がガス導入管B57の内側に堆積するため、基板52上に堆積する薄膜の均一性が悪くなる。

…ガス導入管B、57…電極。

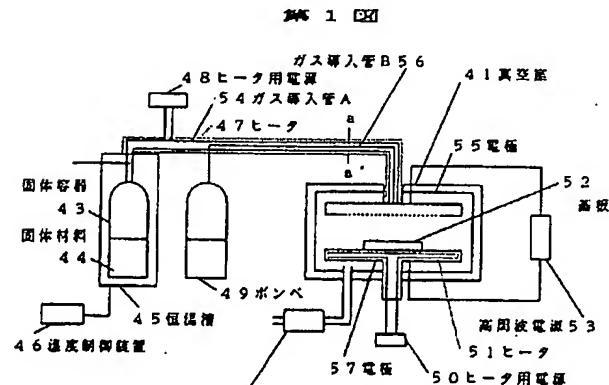
代理人 弁理士 松田正道

人管の内部で反応するためガス導入管の内部に粉末状の生成物が発生し基板上に粉末が堆積したり導入管のコンダクタンスが変化してガスの供給量が不安定であったが、本発明の薄膜形成装置によれば、複数種類のガスが真空室に導入されるまで混同しないので、そのような粉末状の生成物は発生せず均一性の高い膜が堆積できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における薄膜形成装置を示す構成図、第2図は同実施例のガス導入管を示す断面図、第3図は本発明による薄膜形成装置を用いて形成したTa₂O₅薄膜と従来例によるTa₂O₅薄膜のリーク電流特性を示すグラフ、第4図は従来の薄膜形成装置を示す構成図である。

41…真空室、42…真空排気ポンプ、43…固体容器、44…固体材料、45…恒温槽、46…温度制御装置、47…ヒータ、48…ヒータ用電源、49…ポンベ、50…ヒータ用電源、51…ヒータ、52…基板、53…高周波電源、54…ガス導入管A、55…電極、56…ガス導入管B、57…電極。



第2図

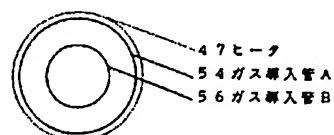


図3

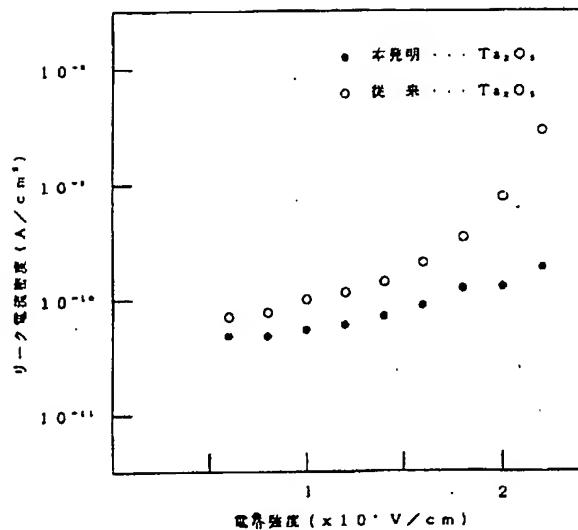


図4

